

<div><div>HX</div><div>汉芯科技</div></div>		山东汉芯科技有限公司 ShanDong HanXin Technology Co., Ltd TEL:0632-7528601 FAX:0632-7528604		文件编号 BD-HXQ73-SOP08011			
		文件名称 SOP8L 焊线图					
芯片型号	HS6002	产品名称	HS16P2811	客户代码	HXQ73	版本	A
版本信息:							
版本	修改内容			修改日期	修改人		
A	初版发行			2024-11-06	卢圣琼		
<div>➡ 进料方向</div> <div><div><div>60框架: 0.38±0.1mm 80框架: 0.63±0.1mm</div><div><div>4</div><div>3</div><div>2</div><div>1</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div>60框架: 0.47±0.1mm 80框架: 0.72±0.1mm</div></div><div>Side View</div><div>Top View</div><div><div>GND PA0 PA1 PA2</div><div>8 7 6 5</div><div>MARK</div><div>1 2 3 4</div><div>VDD PA7 PA6 PA5</div></div></div>							
<div>➡ 进料方向</div> <div><div><div>12排进料方向</div><div>8排进料方向</div></div></div>							
项 目	参数信息			<div>备注:</div> <div>PAD(焊盘)铝层厚度: 1.2um</div> <div>PAD 下方是否有敏感器件?</div> <div>√有 无</div> <div>客户注意:</div> <div>焊接时, PAD 下方或附近有敏感器件时, 压焊会影响成品率和可靠性。</div> <div><input type="checkbox"/> 试产 <input type="checkbox"/> 直接量产</div> <div>(直接量产我司不予保证良率)</div> <div>客户确认签字:</div>			
划片道宽度	60um						
框架规格	12 排:80*80mil ² /60*60mil ² 8 排:80*80mil ²						
粘胶型号	导电胶						
芯片尺寸	835*590um ² (不含划片道)						
芯片厚度	260±10um						
焊点尺寸	49*49um ²						
焊点间距	NA						
焊线根数	8 根						
焊线总长	NA						
焊线线径	合金线/20um						
制 定	卢圣琼	审 核	<div>2024.11.06</div>	批 准	<div>2024.11.07</div>		
制 定 日 期	2024-11-06	审 核 日 期		批 准 日 期			